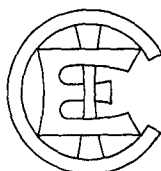


COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

Amendment



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse

n° 1
Août 1985
à la

No. 1
August 1985
to

Publication 317-4
1970

Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage

Quatrième partie:
Fils de section circulaire en cuivre émaillé soudable

Specifications for particular types
of winding wires

Part 4:
Self-fluxing enamelled round copper wires

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Comité d'Etudes n° 55, furent diffusés en janvier 1984 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de documents 55(Bureau Central)271 et 272.

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote, documents 55(Bureau Central)281 et 282.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Technical Committee No. 55, were circulated for approval under the Six Months' Rule in January 1984, as Documents 55(Central Office)271 and 272.

Further details can be found in the Report on Voting, Documents 55(Central Office)281 and 282.

© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Page 20

Remplacer l'article 17 existant par le suivant:

17. Essai de brasabilité

17.1 Diamètre nominal du conducteur jusqu'à et y compris 0,1 mm

La température du bain de soudure doit être de 375 ± 5 °C. Le temps d'immersion doit être de 2 s.

La surface du fil étamé doit être lisse, sans trous ni résidus d'émail.

17.2 Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,1 mm

La température du bain de soudure doit être de 375 ± 5 °C. Le temps d'immersion (en secondes) doit être le multiple ci-dessous du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) avec un minimum de 3 s.

Grade 1	Grade 2
10 ×	15 ×

La surface du fil étamé doit être lisse sans trous ni résidus d'émail.

Page 22

19. Tangente de l'angle de pertes diélectriques

Ajouter la note suivante à cet article:

Note.- Cet essai est applicable seulement aux fils utilisés dans des bobinages haute fréquence.

Page 21

Replace the existing Clause 17 by the following:

17. Solder test

17.1 Nominal conductor diameter up to and including 0.1 mm

The temperature of the solder bath shall be 375 ± 5 °C. The immersion time shall be 2 s.

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

17.2 Nominal conductor diameter over 0.1 mm

The temperature of the solder bath is 375 ± 5 °C. The immersion time (in seconds) shall be the following multiple of the nominal conductor diameter (in millimetres) with a minimum of 3 s.

Grade 1	Grade 2
10 ×	15 ×

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

Page 23

19. Dielectric loss tangent

Add the following note to this clause:

Note. - This test is only applicable for wires to be used in high-frequency coils.